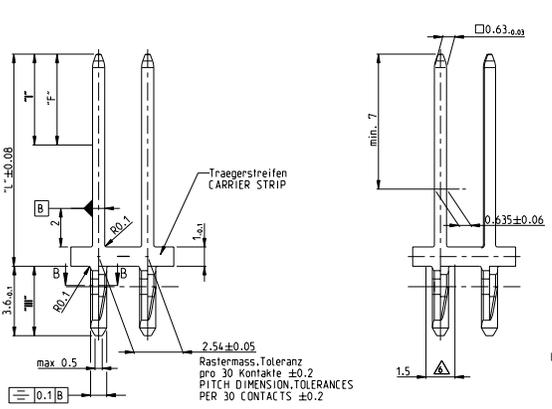
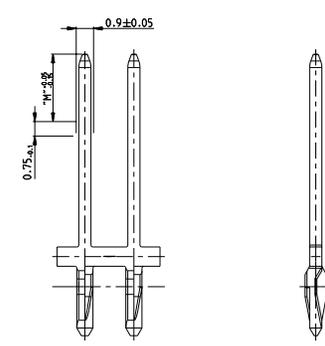


### VERSION A



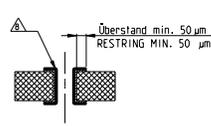
2.54±0.05  
 Rastermaß, Toleranz  
 pro 30 Kontakte ±0.2  
 PITCH DIMENSION, TOLERANCES  
 PER 30 CONTACTS ±0.2

### VERSION B



- Bemerkungen**  
 NOTES
- 1. Massgebend ist der deutsche Text  
 ONLY THE GERMAN LANGUAGE VERSION SHALL BE BINDING
  - 2. Verwendung fuer Leiterplattendicke: 1.6 ±0.14mm  
 USED ON PCB THICKNESS: 1.6 ±0.14mm
  - 3. -
  - 4. Lötbarkeit nach DIN 40046  
 SOLDERABILITY ACCORDING TO DIN 40046
  - 5. Kontaktsitzf. siehe Zeichnung, TE 114-18063, Version B  
 CONTACT PIN SEE DRAWING TE 114-18063, VERSION B
  - 6. Zustand vor dem Einpressen  
 STATUS BEFORE INSERTION
  - 7. Zulaessige Saebelroemigkeit: 40mm/m  
 PERMITTED SABERSHARPNESS: 40mm/m
  - 8. Einpresszone fuer 1.6mm Leiterplatte  
 Anforderung an Leiterplattenloech, siehe Tabelle  
 PRESS-IN AREA FOR 1.6mm PCB  
 REQUIREMENTS ON PCB HOLE, SEE TABLE
  - 9. Verpackungseinheit: 50.000 Stck. auf wiederverwendbarer  
 Kunststoff-Spule Ø 588mm mit Zwischenlagenpapier, 3 Spulen im Karton  
 PACKAGING UNIT: 50.000 PCS ON REUSABLE PLASTIC REEL DIA.588MM  
 WITH INTERLAYING PAPER, 3 REELS IN BOX
  - 10. Lochaufbau (Zinn/Blei) in der Leiterplatte (siehe Tabelle)  
 HOLE CONSTRUCT (TIN/LEAD) FOR PCB (SEE TABLE)
  - 11. Lochaufbau (Nickel/Gold) in der Leiterplatte (siehe Tabelle)  
 HOLE CONSTRUCT (NICKEL/GOLD) FOR PCB (SEE TABLE)
  - 12. Lochaufbau (Zinn) in der Leiterplatte (siehe Tabelle); noch nicht erprobt  
 nach TE-Spezifikation 108-18643  
 HOLE CONSTRUCT (TIN) FOR PCB (SEE TABLE); NOT YET APPROVED ACC. TO TE SPECIFICATION 108-18643

**Lochbau in der Leiterplatte  
 HOLE CONSTRUCT FOR PCB**



Lochbau / P HOLE CONSTRUCT PCB	1	2	3
Kupferschicht COPPER COATING	25-75 µm	25-75 µm	25-50 µm
Zinn/Blei Schicht TIN/LEAD COATING	4-10 µm	-	-
Zinn Schicht TIN COATING	-	-	0.5-1.5 µm
Nickel Schicht NICKEL COATING	-	max. 5 µm	-
Gold Schicht GOLD COATING	-	max. 0.2 µm	-
Bohr-Ø HOLE DIA.	1.15±0.025	1.15±0.025	1.15±0.025
Plattierter Ø PLATED DIA.	0.94+0.15	0.94+0.15	1.07-0.055

<b>Zone I</b> AREA	Goldaufoehrung: 0.8 µm bis 2 µm Au ueber Ni GOLD VERSION: 0.8 µm TO 2 µm Au OVER Ni Zinn-Aufoehrung: 1 µm bis 3 µm Sn TIN-VERSION: 1 µm TO 3 µm Sn
<b>Zone II</b> AREA	Schichtdicke: COAT THICKNESS: 1.3 µm bis 2.2 µm Ni
<b>Zone III</b> AREA	Schichtdicke: COAT THICKNESS: 0.8 µm bis 1.8 µm Sn ueber Ni OVER Ni

VERSION	TE	BESTELL-NR. ORDER NO.	REV.	MATERIAL	DRUCKFLAECHE SURFACE AREA "F"	BOHR-Ø HOLE DIA.	PLATTIERTE PLATED DIA.						
A	40	2-963964-8	A	Zinn/TIN		7	9.2	-	12.8				
		3-963964-7	A	Gold/GOLD		5.5	11.1	-	14.7				
		2-963964-7	A	Zinn/TIN		7	11.1	-	14.7				
B	40	2-963964-6	B	Zinn/TIN		7	13.6	7.75	17.2				
		2-963964-5	C	Cu/NiSi FS8		8.2	17.8	9.25	21.4				
		9-963964-4	A	Zinn/TIN		7	13.6	7.75	17.2				
A	40	3-963964-4	B	Zinn/TIN		7	9.8	-	13.4				
		3-963964-4	A	Gold/GOLD		5.5	9.8	-	13.4				
		2-963964-4	B	Zinn/TIN		7	9.8	-	13.4				
A	40	1-963964-4	B	Gold/GOLD		5.5	9.8	-	13.4				
		2-963964-3	B	Zinn/TIN		7	8.05	-	11.65				
		1-963964-3	B	Gold/GOLD		5.5	8.05	-	11.65				

1:1

TE 114-18063	0002002	140 Electronics AMP Gen D - 8425 Berchtesg.
MGS	00778	CS-963964
ACTION PIN FOR 1mm HOLE ACTION PIN fuer 1mm Loch, Freislehend		
STAB	00778	CS-963964
REV.		
CUSTOMER DRAWING		